



深圳市商务发展促进中心  
(深圳市世贸组织事务中心)

# 贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 20 期】

发布日期: 2023 年 7 月 3 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

【中国】美商务部正式公布《芯片法案》半导体制造激励最新申请流程；美国政府正考虑在人工智能芯片上对中国实施新的出口限制；美国修订《有毒物质排放清单》。

【欧盟】日本和欧盟举行部长会议，确认就经济安全合作；欧盟计划年内出台措施加强管控两用物项的出口和投资风险。

【其他】日本与荷兰签署半导体合作备忘录；日企计划设备投资额创新高，对中国减少 7.5%；世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉谈未来 10 年贸易趋势：高增长来自数字化、绿色贸易等三大领域；日本重新将韩国列入出口优惠国名单；荷兰政府最快将于 6 月底公布新的对华出口限制措施；荷兰通过《投资、兼并与收购安全测试法》；英国实施发展中国家新贸易措施；越南宣布禁止不符合国家标准规定的最低能源效率标准的设备。

### 二、技术性贸易措施通报信息

新加坡通报 1 项节能产品相关措施（通报号 G/TBT/N/SGP/70）；

美国通报 1 项吊扇相关措施（通报号 G/TBT/N/USA/1062/Rev.1）；

欧盟通报 1 项杀菌剂产品相关措施（通报号 G/TBT/N/EU/988）；

巴西通报 1 项信号干扰设备相关措施（通报号 G/TBT/N/BRA/1486）。

## 一、进出口贸易政策及合规信息

### 美国

#### (一) 美商务部正式公布《芯片法案》半导体制造激励最新申请流程

近期，美国商务部正式公布大型半导体供应链项目的激励申请流程，并表示近期将发布针对小型半导体供应链项目的单独流程。其中大型半导体供应链项目指包括资本投资在内大于等于 3 亿美元的材料和制造设备设施项目，小于 3 亿美元的属于小型半导体供应链项目。半导体制造激励补助总量高达 390 亿美元。申请流程主要包括：对于先进节点的商业制造设施，现正以滚动方式接受预申请（可选）和完整申请；对于当前一代和成熟节点的商业制造设施，目前正滚动接受预申请（可选但建议），并将从 2023 年 6 月 26 日开始滚动接受完整申请；对于资本投资等于或超过 3 亿美元的大型材料和制造设备供应商设施项目，将从 2023 年 9 月 1 日开始滚动接受预申请（可选但建议），并从 2023 年 10 月 23 日开始滚动接受完整申请。

作为两党合作的 CHIPS 和科学法案的一部分，商务部正在监督超过 500 亿美元来振兴美国的半导体产业，包括 390 亿美元的半导体制造奖励。第一个资助机会寻求项目申请，以建设、扩大或更新商业设施，生产前沿、当前一代和成熟节点的半导体。这个资助机会现在也对资本投资等于或超过 3 亿美元的材料和制造设备设施项目开放。

现在符合条件的大型供应链项目将遵循第一次资助机会中规定的五部分申请程序：兴趣声明、预申请（可选，但建议）、完整申请、尽职调查、以及奖项准备和发布。对申请人的评估将主要基于申请涉及该计划的经济和国家安全目标的程度，但也将基于商业可行性、财政实力、项目技术可行性和准备情况、劳动力发展和更广泛的影响进行评估。

一个额外的资助机会将在秋季发布，用于低于 3 亿美元门槛的供应商项目，并有一个定制的应用程序，较小的企业可以浏览。

目前 CHIPS 制造奖励的申请过程和时间表：

●对于前沿的商业设施：预先申请（可选）和正式申请都是以滚动方式接受的。

●对于当前一代和成熟节点的商业设施：目前正在滚动接受预申请（可选，但建议），从 2023 年 6 月 26 日起，将滚动接受正式申请。

●对于资本投资等于或超过 3 亿美元的大型材料和制造设备供应商设施项目：从 2023 年 9 月 1 日起，将滚动接受预申请（可选择但建议），从 2023 年 10 月 23 日起，将滚动接受正式申请。

●对于所有潜在的申请人：该部继续以滚动方式接受兴趣声明，以进一步了解感兴趣的项目，并使申请审查更有效率。

即将推出的 CHIPS 制造业激励措施申请流程和时间表：

●对于低于 3 亿美元的小型材料和制造设备供应商设施项目：该部将在秋季发布一个额外的资助机会，并提供申请程序和时间表的细节。

●对于商业研发设施：该部随后将发布一个单独的资助机会，其中有关于申请程序和时间表的细节。

随着 CHIPS for America 在整个供应链上的投资，商务部将优先考虑强有力的国际参与。通过双边和多边对话，以及企业对企业 and 政府对企业的论坛，商务部将与志同道合的伙伴合作，加强全球半导体供应链并使之多样化。

迄今为止，该部与 CHIPS 有关的国际接触包括与韩国、日本、印度和英国的接触，以及通过印度-太平洋经济框架、欧盟-美国贸易和技术委员会和北美领导人峰会的接触。该部将继续与美国伙伴和盟友密切协调，以推进这些共同的目标，促进我们的集体安全，并加强全球供应链。

## （二）美国政府正考虑在人工智能芯片上对中国实施新的出口限制

据媒体 6 月 27 日报道，美国政府正考虑在人工智能芯片上对中国实施新的出口限制。

报道称，美国商务部最早将于 7 月禁止向中国企业提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片。受此消息影响，英伟达股价下跌超过 2%，超微设备公司股价下跌约 1.5%。

去年 9 月，英伟达曾表示美国政府要求该公司停止向中国出口两款用于人工智能的顶级计算芯片。几个月后英伟达表示它将向中国提供一种型号为 A800 的新型高端芯片，其性能低于美国商务部规定的门槛，且无法通过编程方式使传输速度超过出口管制的限制，以满足美国的出口管制要求。今年年初该公司又调整了其旗舰产品 H100 芯片以符合相关规定。

但报道称，美国商务部正在考虑的新限制措施，将禁止在没有美国特定的出口许可的情况下销售 A800 芯片。美国商务部没有立即回应媒体的置评请求。

## （三）美国修订《有毒物质排放清单》

2023 年 6 月 26 日，美国发布通报，修订《有毒物质排放清单》。根据《应急规划和社区知情权法》(EPCRA)和《污染预防法》(PPA)更新了受有毒化学品排放报告影响的化学品清单。具体来说，从 2023 报告年度开始，在有毒物质排放清单中实施法定添加 9 种全氟烷基和多氟烷基物质。该法规将于自 2023 年 7 月 24 日生效。

## 欧 盟

### （一）日本和欧盟举行部长会议，确认就经济安全合作

日本政府与欧盟（EU）27日在线举行了部长级“日本欧盟高级别经济对话”。出于经济安全的观点，确认了将就确保半导体及重要物资供应链等深化合作。双方还就共同应对利用贸易关系中占优势地位的领域向他国施压的“经济胁迫”进行了讨论。

上一次日本与欧盟的经济对话是在去年10月，此次是第三次。日方由经济产业相西村康稔和外相林芳正出席，欧盟方面由执行副主席东布罗夫斯基斯等人出席。

西村在会上强调：“在世界局势和国际秩序持续不稳定的情况下，基于规则的自由且公平的贸易和经济安全的稳定不可或缺。”东布罗夫斯基斯表示“对俄制裁有必要统一方向，为促进和平与稳定而继续合作”。双方还就促进跨国家和地区的数据自由流通的“日本欧盟数字贸易原则”达成协议。急速普及的聊天软件“ChatGPT”等生成式AI则未成为话题。

日方要求尽快取消福岛核事故后欧盟对日本产食品的进口限制措施。

### （二）欧盟计划年内出台措施加强管控两用物项的出口和投资风险

据媒体6月19日报道，欧盟委员会着眼于中国等竞争对手，计划在年内发布相关措施以应对境外投资带来的安全风险和加强两用物项的出口管制。

欧盟委员会在一份名为“欧洲经济安全战略”（European Economic Security Strategy）的文件中阐述了其对欧盟如何使其经济更具弹性并识别新出现的风险的看法。委员会表示，风险可能来自出口和投资，这些出口和投资让专有技术如量子计算、人工智能、6G、生物技术和机器人技术等“狭义的具有军事意义的关键使能技术”（narrow set of key enabling technologies with military implication）泄露给外国竞争对手。欧盟

也重点关注包括能源在内的供应链和电信网络等关键基础设施的风险，以及防范经济胁迫和尖端技术泄漏。

这份文件没有特别点名中国，但强调和与欧盟有共同担忧的国家合作，并使用了“去风险”一词，即减少对中国经济依赖的政策。

欧盟确实控制着可具有军事用途的特定“两用”商品的出口，并且计划与欧盟成员国一起编制一份对经济安全至关重要的技术清单。不过欧盟的执行官需要谨慎行事，因为授予出口许可证和权衡安全利益是欧盟各成员国政府希望保留的国家权限。荷兰正在制定的禁止中国企业购买 ASML 最先进的半导体制造工具的措施就是一个很好的例子。

欧盟委员会还将关注入境投资，并可能在 2023 年底之前提议修改其审查机制。欧盟外交官表示，欧盟必须仔细确定它想要限制的风险，并确定现有措施无法遏制这些风险。

## 其 他

(一) 日本与荷兰签署半导体合作备忘录。据日经中文网报道，日本经济产业省与荷兰经济事务和气候政策部日前在东京签署了半导体领域合作备忘录。主要设想推动力争在日本国内量产最先进半导体的日本 Rapidus 与荷兰阿斯麦 (ASML) 的合作。日本政府将推动两国研究机构的技术开发等。Rapidus 计划运用经济产业省的补贴，采购 EUV 光刻设备。日本为了推动新一代半导体的国产化，已开始和美国合作。Rapidus 向 IBM 派遣了 100 名技术人员，目标是掌握 GAA (全环绕栅极) 技术。

(二) 日企计划设备投资额创新高，对中国减少 7.5%。日本经济新闻社汇总的 2023 年度设备投资动向调查显示，日本全部产业的计划金额比上年度实际投资额增加 16.9%，达到 31 万 6322 亿日元。按照最初计划计算，首次超过了 30 万亿日元。随着纯电动汽车 (EV) 的全球需求扩大，汽车相关投资日趋活跃。在日本劳动力短缺的情况下，人工智能 (AI) 等有助于提高生产率的数字领域的投资也引人注目。随着纯电动汽车的普及，日本的企业投资正在扩大至电池材料和作为汽车“大脑”的软件等在汽油车领域规模曾较小的新领域。虽然世界经济前景不明朗，但在芯片短缺也逐步消除的情况下，日本企业正在增加设备投资。如果增长投资得以持续，或将形成雇用和工资上涨的良性循环。调查以日本国内的上市企业和资本金 1 亿日元以上的 857 家大型企业为对象进行了统计。计划投资额高于自雷曼危机前的 2007 年度以来、时隔 14 年创出历史新高的 2022 年秋季的修正计划 (30 万 8048 亿日元)。面向日本国内的投资连续 2 年保持 2 位数增长。按行业来看，除纸和纸浆、房地产、建筑业 3 个行业之外，均为正增长。汽车增长 16.6%，达 4 万 3455 亿日元，电气设备增长 17.3%，达 5 万 629 亿日元，拉动整体增长。日产汽车等各日本车企也正在增加全球需求增长的纯电动汽车产量。日本企业对日本以外的海外投资增长 22.6%，达到 3 万 8294 亿日元，连续 3 年保持 2 位数增长。大金工业为了

扩大在全球增长的空调设备的生产，将在波兰和墨西哥等 5 个地点建设新工厂。该公司社长十河政则表示：“为实现可持续增长，将进一步加快先期投资”。按地区来看，日本企业面向通过《通胀削减法（IRA）》优待当地生产企业的美国的投资增长 30.7%，超过 1 万亿日元。对欧盟（EU）的投资增长 36.8%，另一方面，对中国投资减少 7.5%。体现出在考虑新冠疫情下的供应链中断和地缘政治风险等的基础上拓展业务的姿态。

**（三）世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉谈未来 10 年贸易趋势：高速增长来自数字化、绿色贸易等三大领域。**6 月 27 日，以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题的世界经济论坛第十四届新领军者年会（即“夏季达沃斯论坛”）在天津开幕。这是三年来论坛首次在亚洲举行线下会议。在本次夏季达沃斯论坛现场，世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉在接受记者采访时分享了对未来 10 年贸易趋势的预判，她表示，“我们可以从数字化（服务）中获得很多收益，目前该领域的增长率达到了 8%，未来还会有更多增长，绿色贸易也是如此（高收益），环保相关的贸易和产品发展很快。第三个机会是尝试将供应链带到还未参与全球化的贫穷国家和新兴市场。”在当天举行的主题为《直面挑战：在脆弱的环境中重启增长》的分论坛上，奥孔乔-伊韦阿拉表示，“全球贸易增长速度去年为 2.7%，今年前瞻是 1.7%。我们想重申下全球割裂的负面影响，贸易增长下滑加之全球脱钩会让情况变得更加糟糕。我们做过测算，这种情况下，对全球可能造成 5% 的 GDP 的损失，相当于整个日本经济体的增长量。所以我们真的脱不起，需要避免脱钩的发生。”奥孔乔-伊韦阿拉呼吁，“我们需要维护一个开放的贸易体系，因为没有多边贸易体系，世界上可能会有一些国家无法获得食物。世界上消耗的五分之一的卡路里都是通过贸易得来的。因此，不要脱钩，不要分裂。”奥孔乔-伊韦阿拉指出，去风险也是各方努力打造全球韧性的一部分，她特别提到了俄乌冲突导致的供应链问题。谈及当前全球面临的多方挑战，奥孔乔-伊韦阿拉在现场表示，“当前全球出现



的一个增长阻力是需要我们密切关注的，即长期的经济引擎疲软，（造成这种局面）可能是因为结构性因素，比如人口老龄化，这需要提前未雨绸缪，让年轻一代劳动力去继续推动经济增长。”

**（四）日本重新将韩国列入出口优惠国名单。**据日经中文网报道，日本政府6月27日在内阁会议上通过了政令修正案，把韩国重新指定为享受出口优惠待遇的“Group A（原白名单国家）”。围绕对韩出口管理，日本在2019年夏季强化限制措施，在4年以后这些措施完全撤销。日本将修改外汇和外国贸易法（外汇法）政令，2023年6月30日颁布，7月21日施行。内阁官房长官松野博一在27日的记者会上表示：“将继续与韩国就双方的制度及其运用进行全面的政策对话”。经济产业省西村康稔27日表示：“如果发生向第三国进行不当出口等问题，将要求对方采取恰当的应对措施”。2019年8月，日本将韩国降级为“Group B”国家。向韩国出口产品时，日本企业需要承受一定的负担。有观点认为这对人手有限的中小企业产生了很大影响。经济产业省当时给出的降级原因是，韩国方面负责审查的人员不足，而且局部没有引入韩国出口可转用于军事用途的零部件和材料时的审查体制。韩国重回Group A之后，虽然国际上规定的“管制清单”品类需要出口许可证，但其他品类原则上不再需要出口许可证。

**（五）荷兰政府最快将于6月底公布新的对华出口限制措施。**据媒体6月23日报道，荷兰政府计划最早于6月最后一周发布新的出口管制措施，以限制更多ASML的芯片制造设备出口到中国。媒体报道称，荷兰政府此前承诺将在今年夏天之前公布的出口管制措施旨在限制该公司的三种浸入式DUV型号的设备（TWINSKAN NXT: 2000i、NXT: 2050i和NXT: 2100i）对华出口，但是并不会提及中国或ASML。另外这些出口管制措施是一份可供其他欧盟成员国使用的蓝图，计划最早于6月30日或7月的第一周公布。荷兰政府发言人拒绝置评。拜登政府在去年10月出台了广泛的出口

管制措施，以限制向中国企业出售先进的半导体和芯片制造技术和设备，并一直在向荷兰和其他国家施压，要求他们帮助阻止中国进一步发展自己的芯片产业、在人工智能和量子计算等技术上取得进步和强化军事能力。今年1月，荷兰和日本政府宣布原则上同意加入美国的对华出口限制行动。美荷日三国是当今世界上最大的半导体制造设备来源，拥有制造世界上最先进半导体所需的专业技术。

**（六）荷兰通过《投资、兼并与收购安全测试法》。**6月1日，荷兰《投资、兼并与收购安全测试法》正式生效，允许投资审核局审查外国技术投资并以国家安全为由限制投资规模或阻止收购，旨在保护知识密集型公司免受不必要的知识转移。

**（七）英国实施发展中国家新贸易措施。**英国新的发展中国家贸易措施(Developing Countries Trading Scheme, DCTS)于6月19日起生效。新制实施后，英国从发展中国家(如印度)进口床单及桌布用品和类似产品的关税将上涨20%。这些产品将按12%的最惠国关税税率征收，而不是9.6%的普遍性优惠措施减税税率。估计新制实施后将导致英国进口商每年关税支出增加约2万7000英镑。英国实施发展中国家贸易措施，是为取代2021年脱欧前实施的普遍性优惠措施(Generalised System of Preferences)。英国商业和贸易部发言人表示，新制实施后，许多关税将被降低或取消，同时原产地规则将针对该措施受益者的发展中国家和最不发达国家进行简化。

**（八）越南宣布禁止不符合国家标准规定的最低能源效率标准的设备。**越南发布第14/2023/QĐ-TTg号决议，旨在淘汰低效设备并禁止其开发和进口。该决议适用于多种设备类别，包括家用电器、办公和商业设备，以及工业机械。该决议强制执行日期将于2023年7月15日或2025年4月1日开始，具体日期取决于产品类型及其相关国家标准的生效日期。请注意，该决议禁止进口、制造和销售不符合国家标准规定的最低能源效率

标准的设备。

## 二、技术性贸易措施通报信息

### (一) 新加坡通报 1 项节能产品相关措施

2023 年 6 月 26 日，新加坡通报了 1 项节能产品相关措施，通报号为 G/TBT/N/SGP/70。该措施修订了《节能法》（ECA）下的《节能（受管制商品和注册供应商）条例》和《节能（规定受管制商品）令》。

具体信息如下：

通报成员：新加坡

通报号：G/TBT/N/SGP/70

涉及领域：节能产品

拟批准日期：待定

拟生效日期：详见通报单

生效日期：2023 年 8 月 7 日

### (二) 美国通报 1 项吊扇相关措施

2023 年 6 月 23 日，美国通报了 1 项吊扇相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/1062/Rev.1。该措施规定了吊扇的新的和修订的节能标准，根据修订后的《能源政策和保护法》，现就技术可行性、经济合理性以及节能成效方面征求意见。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1062/Rev.1

涉及领域：吊扇

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 8 月 12 日

### **（三）欧盟通报 1 项杀菌剂产品相关措施**

2023 年 6 月 20 日，欧盟通报了 1 项杀菌剂产品相关措施，通报号为 G/TBT/N/EU/988。该措施批准了甲酸作为活性物质用于 2、3、4、5 类产品的杀菌剂产品。

具体信息如下：

通报成员：欧盟

通报号：G/TBT/N/EU/988

涉及领域：杀菌剂产品

拟批准日期：2023 年 11 月

拟生效日期：官方公报发布 20 天后

评议截止日期：2023 年 8 月 18 日

### **（四）巴西通报 1 项信号干扰设备相关措施**

2023 年 6 月 15 日，巴西通报了 1 项信号干扰设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/BRA/1486。该措施更新了信号干扰设备一致性评估和批准的技术要求，包括便携式和移动干扰设备评估参数。

具体信息如下：

通报成员：巴西

通报号：G/TBT/N/BRA/1486

涉及领域：信号干扰设备

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 8 月 20 日